

EDITORIAL

Umverpackung von Hochtemperatur-Elektronikbaugruppen	2537
--	------

VERBÄNDE

 FBDi - Informationen	2577
---	------

F E D - Informationen	2589
------------------------------	------

ZVEL - Informationen	2609
-----------------------------	------

 iMAPS - Mitteilungen	2643
---	------

 3-D MID - Informationen	2665
--	------

DVS - Mitteilungen	2684
---------------------------	------

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes	2540
Neue Normen	2559
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung	2560
Productronica – Impressionen	2562

BAUELEMENTE

Original oder Fälschung?	2566
Verbindungslösungen für die industrielle Netzwerkstruktur einer klugen Fabrik	2568
Distrelec vertreibt neue Alu-Elkos von Panasonic	2570
Neue effizientere und kleinerer DC/DC-Power-Module	2571
Neue Leistungs-MOSFETs für industrielle Applikationen und Fahrzeuganwendungen	2574
Mentor Graphics Hypervisor: Mehrere Betriebssysteme auf einer ECU	2575
SSDs zur anwendungsgerechten Auswahl	2576

DESIGN

Branchenweit erste App für das PCB-Layout	2579
---	------

DESIGN

DesignSpark Mechanical bietet vielen Ingenieuren 3D-Design-Einsatzmöglichkeiten	2581
Fertigung von biegsamen Displays und krummen Akkus	2584
Altium Designer 14 bringt neue Qualität in das Leiterplattendesign	2587
Simulationssoftware – Modellerstellung, Interface und Solver als Entwicklungsschwerpunkt	2588

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit) Was erwartet uns 2014?	2595
APL Oberflächentechnik erweitert Dienstleistungsangebot	2598
Intelligente Prozesse reduzieren Betriebskosten in der Leiterplattenproduktion	2600
Paradigmenwechsel im Bereich der Lötstopplack-Belichtung	2604
Gelungene Eröffnungsfeier mit Branchentalk	2606

BAUGRUPPEN & SYSTEME

GL-Schablonendrucker mit innovativen Aspekten	2616
Produktionsnahe Zwischenlager für die SMD-Fertigung	2618
Innovative Drucklösungen für die Leiterplattenfertigung	2620
Flexible SMT-Lösungen für manuelle Vor- / Nacharbeiten	2622
Elektroniklot SN100C nun auch von der Felder GmbH	2624
Moderne wasserbasierende Reinigung von Hochfrequenz-Baugruppen	2625
Neue Dispenser für die Elektronikmontage	2626
Die- und Flip-chip-Bonder	2628
Heißnieten – Vorteile einer neuen Konstruktionsrichtlinie	2630
Batch-Reinigungssystem als Alternative zu In-Line-Anlagen	2634
Solides Marktwachstum für elektronische Komponenten	2635
Erweitertes Leistungsspektrum im Bereich von Leiterplatten-Layout und Schaltungsentwicklung	2637
Alles im Lot – Elsolid nimmt neues Werk in Betrieb	2639

ANALYTIK & TEST

Kooperationsforum HF-Entwicklung	2653
Marktlücken bei Table-top- und Inline-Inspektion geschlossen	2656
Testen von elektronischen Flachbaugruppen in der Praxis	2658
Optimale Inspektion von THT-Baugruppen	2661
Neuer GRS550 Flying Prober von Polar Instruments	2664
Lötbarkeitstester arbeitet mit Lotpaste und Temperaturprofil	2664

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Hochzuverlässiger Haftvermittler zwischen Mold-Komponenten und Silberoberflächen	2669
Patente	2678

FORUM

Microelectronics Europe – SEMICON Europa2013 und Plast Electronics2013	2686
Lean Production im Prozess	2700
Qualitätsmanagement – wie macht man alles neu und erhält dabei Altbewährtes	2703

Schüler präsentieren eigene Innovationen	2706
Weniger Platzbedarf und höhere Bildqualität im Ultraschall-Equipment	2708
Intelligenter Super-Kampfanzug mit viel Elektronik geplant	2710
Kolumne – Anders gesehen: Haben Sie die Nase auch voll?	2712
PLUS-Firmenverzeichnis	2714
Firmenindex	2738
Inserentenindex	2740
Stellenmarkt und Kleinanzeigen	2741
Anzeigenformate und Preise	2742
Impressum	2743
Produkt des Monats	2744

Titelbild: EP/EPAG weist im Vergleich zu Endoberflächen wie ENIG, ENEPIG oder elektrolytisch Nickel/Gold große Vorteile bezüglich Kosten, Bondbarkeit, Anzahl der Prozess-Schritte, geringerem Einfluss auf Stopplacke und Basismaterialien auf. Die EPAG-Oberfläche ist mittels verschiedenster Drahtbondtechniken bondbar. Die Markteinführung von EPAG erfolgt im 1Q/2014.
Weitere Informationen: www.apl-ssc.com

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e.V.,
Tel. +49/8165/670233,
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251,
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.,
Tel. +49/30/8349059,
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437,
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e.V.,
Tel. +49/3677/69-3381,
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/911/5302-9100,
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect
Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281,
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0,
michael.weinreich@dvs-hg.de,
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.